

无溶剂型 · 水性 粘合剂

[NONSOLBOND]

WA系列(水性分散型)

由于为自乳化型水性聚氨酯分散体(PUD),所以不需要为了分散而使用的界面活性剂,同时在耐热性,耐热水性方面表现优良.

- 作为PUD的安定性高,有多用途型的#300系列,耐热性与膜层强度优良的#500系列,以及在生产线上不使用所有溶剂的#400系列。
- WA系列基本上是属于与硬化剂混合使用的二液型粘合剂。

X系列(树脂100%型)

开发出来用于贴合加工的液状二液反应硬化型粘合剂.

- 不需要干燥过程,是属于经济环保型粘合剂。
- 但是,由于在室内温度情况下为高黏度(或者是固体形状),使用时需要加热,所以用来贴合的设备必须是带有调整温度功能的涂布机的来贴合设备(NONSOL LAMINATER).此外,必须按照指定的配方进行混合,还要有特定的供料机进行供料。
- 基本上这些二液型(或者是三液型)粘合剂符合日本食品卫生法。

NONSOLBOND WA的特征

- 1.适用于除了铝箔以外的一般塑料薄膜或者发泡物的粘合。
- 2.WA用的硬化剂有异氰酸酯型与非异氰酸酯型。

NONSOLBOND X的特征

1. 与各种塑料薄膜的粘合性良好. 根据不同的产品还可以提高与铝箔或者透明金属化薄膜的适应性.(XE/XC系列)
2. 对塑料薄膜的可湿性良好可以在辊式涂布机上进行薄膜涂布。

备注: 无论是WA系列还是X系列,与贴合设备的适应性是个重点.
如有需要适合贴合设备产品的要求时,敝公司接受这方面的质询.

用途

- 各种塑料薄膜制的食品包装材料用粘合剂.
- 其它各种塑料薄膜制的软包装用粘合剂.

NONSOLBOND WA 具有代表性的产品

产品名	固形物含量 (%)	黏度 (mPa · s/25℃)	硬化剂 (有代表性的)	配方 (重量比例)	用途以及特征
主 剂					
WA-374	45	1000~10000	C-95	100:5	粘合剂. 粘结剂.
WA-377	40	10~2000	C-96	36:1	软包装材料 · 干燥食品用. 二液型.
			C-24 C-96	36:1:1	软包装材料 · 水煮用. 三液型设计.
WA-515LV	39	10~2000	C-24	100:5	工业用. 耐湿热性.
WA-568	40	100~5000	C-24	100:5	工业用. 高结晶型.
WA-470	50	100~6000	C-24	100:5.5	无VOC设计. 软型.
WA-472	45	100~10000	C-24	100:5	无VOC设计. 软型.
硬化剂					
C-24	-	2000~3000			异氰酸酯型.
C-95	-	150~350			异氰酸酯型.
C-96	-	400~1000			非异氰酸酯型.

NONSOLBOND X 具有代表性的产品

主剂	成分	黏度 (mPa · s/80℃)	硬化剂	成分	黏度 (mPa · s)	用途以及特征
XC-231	NCO	600~1000	XA-126	OH	350~500(70℃)	软包装材料
XC-235	NCO	700~1400	XA-129	OH	100~300(40℃)	软包装材料
XC-236	NCO	1000~1500	XA-129	OH	100~300(40℃)	软包装材料
XE-261	OH	4000~6000	XC-151	NCO	50~150(80℃)	软包装材料水煮蒸煮用

标准配方比例(重量比) 主剂: 硬化剂=10:4